

ALPHA[®] OM-372

高电化学可靠性、超精细特征免清洗锡膏

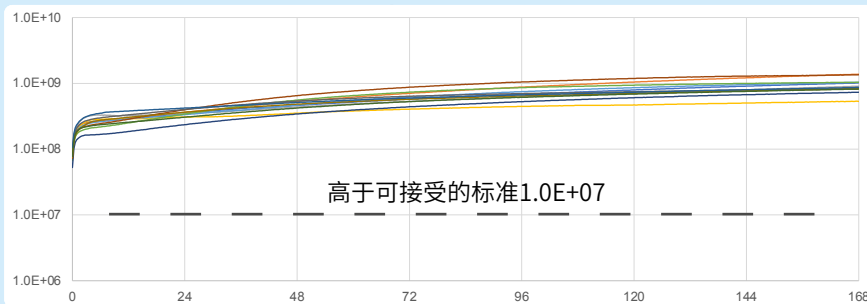
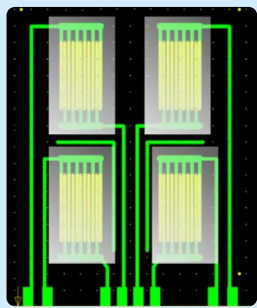
可用于下一代高密度组装的创新锡膏

ALPHA OM-372 是一款专门为组装超细间距组件而设计的锡膏。其卓越的性能，能够满足这些组件对于优秀钢网转移效率和高电气可靠性的要求。例如在移动和可穿戴设备、电脑和医疗设备中的器件。

- 在超精密间距的低间隙封装上具有业界最佳的电气可靠性
- 超精密器件印刷和回流能力，可用于细小至008004的元件
- 在高密度线路板设计上，回流后生成的残留物最少
- 在高 I/O 数量的封装上，具有优异头枕/非润湿开焊(NWO)性能
- 免清洗、完全不含卤素



ALPHA OM-372 玻璃覆盖表面绝缘阻抗 100um 间距 (85°C/85%RH/10VDC 偏压)



ALPHA OM-372在超级表面绝缘阻抗 (SIR) 玻璃载片测试中显示出优异的结果。



标准免清洗锡膏
显示出有问题的晶枝生长



ALPHA OM-372锡膏
无晶枝生长

由于移动和计算领域的极端小型化而开发出的专用的SIR测试，该测试使用玻璃载片捕获助焊剂残留物。

ALPHA OM-372表现出优异的电化学可靠性，并且在低间隙元件上没有晶枝生长。

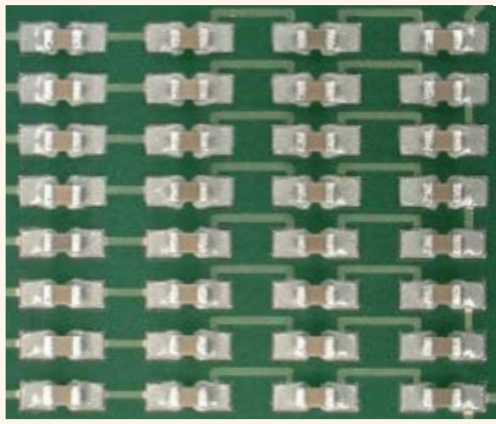
alpha 

ALPHA[®] OM-372

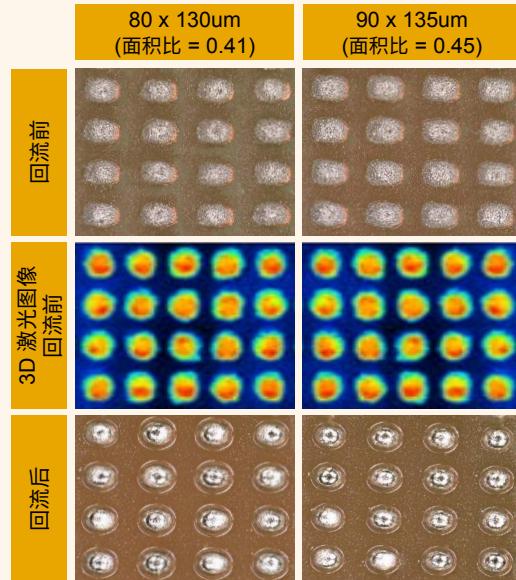
为细间距、低间隙元件提供超高电化学可靠性

超精密特征熔合 – 网板 T60um, SAC305 88.2-6-M10, T6号粉

ALPHA OM-372 SAC305 T6 可在细小至80 x130 的开孔尺寸中熔合而无葡萄颗粒化象。



008004(M0201) 电容



性能总结

工艺优点	属性	性能表现
印刷工艺窗口	超精密印刷精度	80um x 130um 焊盘 (008004 元件, 面积比 = 0.41)
	网板寿命	超过 8 小时稳定转移效率
	印刷速度范围	25 - 100 mm/s (1-4 in/s)
回流良率	回流环境	氮气 (建议氧气浓度1000ppm)
	抗空洞性能	BGA/LGA 满足 IPC 7095 第 III 级要求
	随机焊球	优选 根据 IPC J-STD-005A
	头枕/非润湿开焊(NWO)	高防止头枕/非润湿开焊(NWO)性能
	熔合	在微小至 80um*130um 元件(60um 网板厚度)上, 具有优异的熔合性能
电气可靠性	助焊剂残留物特性	浅琥珀色、透明的残留物
	超级表面绝缘阻抗	在100µm 间隔的玻璃夹层中 7天内保持 ≥107 Ohms; 确保在精密间距的低间隙封装上, 具有优异的电气可靠性和功能性
	IPC/JIS 表面绝缘阻抗	合格 (根据 IPC J-STD-004B/JIS Z 3197)
	电子迁移	合格 (根据 IPC-TM-650 Method 2.6.14.1)
环保	分类	ROLO (根据 J-STD-004B)
	卤素含量	完全不含卤素, 无特意添加卤素



macdermidalpha.com
November 2020

Alpha is a product brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions.

欲了解更多信息, 请联系 Assembly@MacDermidAlpha.com

© 2020 MacDermid, Inc. and its group of companies. All rights reserved.

® and ™ are registered trademarks or trademarks of MacDermid, Inc. and its group of companies in the United States and/or other countries.